

## 日月光一〇三年度第二季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 103 年 7 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇三年度第二季獲利報告，本公司一〇三年第二季之合併營業收入較一〇三年第一季成長 7%，較一〇二年同期成長 15%，為新台幣 58,615 百萬元。茲將日月光一〇三年度第二季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

### 合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	103 年度 第二季	103 年度 第一季	102 年度 第二季	103 年度 上半年	102 年度 上半年
營業收入淨額	58,615	54,700	50,760	113,315	98,950
營業毛利	12,600	10,349	10,436	22,949	18,717
營業淨利（淨損）	6,600	5,070	5,403	11,670	9,006
稅前淨利（淨損）	6,050	4,284	5,038	10,334	8,197
所得稅利益（費用）	(818)	(727)	(1,127)	(1,545)	(1,930)
非控制權益	(138)	(119)	(91)	(257)	(216)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	5,094	3,438	3,820	8,532	6,051
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.64	0.44	0.50	1.08	0.79

### 綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	103 年度 第二季	103 年度 第一季	102 年度 第二季	103 年度 上半年	102 年度 上半年
營業收入淨額	39,266	34,351	36,295	73,617	67,612
營業毛利	10,588	8,243	8,723	18,831	14,947
營業淨利（淨損）	5,973	4,210	4,810	10,183	7,479
稅前淨利（淨損）	5,779	4,038	4,833	9,817	7,609
所得稅利益（費用）	(647)	(570)	(975)	(1,217)	(1,481)
非控制權益	(38)	(30)	(38)	(68)	(77)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	5,094	3,438	3,820	8,532	6,051
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.64	0.44	0.50	1.08	0.79

### 半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	50
電腦	12
汽車及消費性電子	38
其它	0
前十大客戶佔營收比重	46

銷售地區別佔比	%
北美	60
歐洲	10
台灣	18
日本	6
亞洲其它地區	6

封裝業務產品組合	%
Advanced Packaging	26
IC Wirebonding	64
Discrete and Others	10
封裝資本支出金額	257 百萬美元
打線機台數	15,762 台

測試業務產品組合	%
後段測試	77
晶圓測試	21
前段測試	2
測試資本支出金額	54 百萬美元
測試機台數	3,244 台

### 電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	44
電腦	24
消費性電子	11
工業用	12
汽車電子	8
其它	1
前十大客戶佔營收比重	84
EMS 資本支出金額	43 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2014 年第三季的業績展望如下：

- 半導體封測事業之整體產能將較上一季增加約 4%，整體產能利用率將由第二季的 80% 增加 2-4%；
- 電子代工服務第三季營運狀況將延續上半年跟去年同期比較之成長趨勢；
- 合併營業毛利率將小幅度下滑，而合併營業淨利率將略為上升。